

フレキシブル基板

Flexible Printed Circuit Board

特長 Features

- 試作～量産までベトナム工場にて一貫生産 (IATF16949取得)
- 同建屋にてEMS (実装) まで対応可能
- 基材 (FCCL) は要求仕様により、PET, PI, PTFEの選択が可能



製品例 Product example

多様化する車載ニーズや、5G環境のニーズに対応しています

- ライト・トランスミッション等向け 高耐熱FPC (～150℃)
- Antenna cable用 多層FPC ※3L High Speed Type
- Foldable Mobile Hinge部 多層FPC (6L, 5L) ※Air Gap Type



- BMS向け 長尺FPC
- カーナビ液晶向け 両面FPC



- Finger Print用 両面FPC



- Battery pack用 多層FPC (4L)

構造例 Product example

	1Lay & 2Lay		Multi Layer
Structure	<p>1Lay FPC</p>		<p>Layer count 3～6L</p>
	<p>2Lay FPC</p>		
Cross-section	<p>2Lay FPC</p>		<p>4Lay FPC</p>
Thickness	63～※1	135～※1	200～※2
Min. L/S	40/40	50/50	Inner Layer 40/40 Outer Layer 60/60
Min PTH/LAND	N/A	125/325	125/325
Min VIA/LAND		100/250	100/250

上記は参考になります。詳細については、お問い合わせください。
 ※1 厚みは補強板なしの値になります。 ※2 厚みは層構成により変わります。

Roll to Roll プロセス

Roll to Roll process

概要 (Set-up Summary)

- レーザー加工～AOIまで一貫処理
- 長尺・薄物製品に対応

導入メリット (Benefits)

- 高スループットで生産性向上
- ハンドリング削減で品質安定化



BMS FPC イメージ図

Roll to Roll / 枚葉 生産方式特徴比較

(Roll-to-Roll vs. Sheet Process: Key Differences)

	Roll to Roll	枚葉式
生産性	連続搬送で高スループット	1枚ごと処理でタクト長い
品質安定性	ハンドリングレスで安定	ハンドリングを伴う運用
製品適正	長尺・薄型・大量生産向き	小～中ロット、多品種向き

導入スケジュール (Schedule)

2026年度 量産開始